

## 精測將於台灣半導體展上首次亮相 展示高端垂直探針卡與先進技術能力

發佈單位：中華精測科技股份有限公司 (股票代號：6510)

發佈日期：2017/9/11

中華精測攤位(I 2100)將展出微機電垂直探針卡(MEMS Vertical Probe Card)，用於檢測手機應用處理器(AP---application processor)、射頻(RF---radio frequency)等高速、高密度之先進製程晶圓。這是一款能在超低工作電壓及高速測試訊號情況下，同時檢測多顆晶粒(Multi-Die)的晶圓測試方案，此方案能有效縮短測試時間，降低測試成本；且因良好的可靠度及較長的壽命，更可滿足客戶量產之需求。

精測其它技術展示：

- 探針元件特性：精測所使用的探針，因其材料與結構特性，使其與其它相同尺寸的探針相較，可乘載較大的電流，並有較佳的機械特性；因而可用於製作高腳數、微間距的探針卡，並提供良好的測試特性及較長的測試壽命。
- 探針卡高速訊號控制技術：隨著消費者對速度提升的需求，導致晶圓的速度也逐年提升，這對探針卡供應商而言是一極大挑戰，但對精測言，是高速技術應用上難得的機遇，因精測具有完整的探針卡整合能力，能以最佳法則，安排高速訊號路徑，並善用探針數量、間距和針長等可變因子，提昇高速訊號傳輸的穩定性。

參展期間，精測總經理黃水可先生將於 9 月 13 日下午 1:30，在展出攤位 I 2100 接受媒體採訪，說明高階探針卡在先進製程中扮演的關鍵角色。

關於精測

精測產品晶圓測試卡與晶片測試板，是為檢測高階之微間距、細線路、高腳數、高縱橫比、高頻的產品，如應用處理器、繪圖晶片、網通晶片、中央處理器等，屬於智慧型手機、人工智慧、高速運算電腦、雲端和邊緣運算等領域。

精測 2017 上半年 7 奈米、10 奈米、14/16 奈米產品分別占營收比重約 10%、60%、6%。在高效能低功耗的產品需求下，7 奈米等先進製程將是 2018 年精測營運成長動能。當這些先進晶圓測試時，常需面對的電源供給問題，精測能從模擬、設計、生產、量測完整的一套程序，提供有效的解決方案。

全球半導體設備支出逐年成長，精測預估今年設備支出約為新台幣 4 億元，較去年 2.5 億元成長，除了用於突破生產瓶頸的設備購置外，也投資特用設備及材料之研究。精測亦跨足非半導體領域的太空衛星通訊產業，預估總資本支出約新台幣 10.5 億元，但將依建置、驗證與量產時間表分次動用，2017 年先以自有資金支應設備採購約新台幣 4 億元。因此合計 2017 年資本支出共約新台幣 8 億元。

因應營運擴大與產能需求，精測將於桃園新建營運總部，耗資新台幣 16.5 億元，經由發行新股 2,000 千股募集資金，預計 9 月中進行公開競價拍賣，9 月 27 日上櫃交易。新總部樓板面積為目前總部兩倍大，預計於 2019 年第三季啟用，持續為半導體與衛星通訊產業，提供服務。